



出展のご案内

お客様各位

2023年12月1日
康楽株式会社

拝啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「SEMICON Japan 2023」展に出展する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

是非、当社ブースにお越しいただき、ご覧いただければ幸いに存じます。

ご多忙のところ恐縮ではございますが、何卒、ご来臨賜りますようご案内申し上げます。

敬具

――記――

会期 : 2023年12月13日(水) - 12月15日(金) 10:00-17:00

会場 : 東京ビッグサイト (東京)

小間No. : 3920 / Hall 3

出展内容: フッ素樹脂: ペレット、丸棒、シート、加工品

半導体成膜材料: 中国ADCHEM社の日本総代理店
Si系プリカーサ、メタル系プリカーサ

電子材料: Li電池材料、化成品、原材料、貴ガス(He, Ne, Kr, Xe)、高純度薬品
バルブ等、CVD・ALD材料容器: バルブ・部品材料、薬品容器、CVD・ALD材料容器
シリコンウエハー等: シリコンウエハー、SiC・GaNウエハー

**新規開発品: 半導体プリカーサ用レベルセンサー
PEEK樹脂**

主催者 URL : <https://www.semiconjapan.org/jp/>

事前入場登録URL : <https://semi.eventos.tokyo/web/portal/609/event/7901/users/login/>

※当日、会場にて入場手続きを行うことはできません。

事前に入場者バッジを入手して、会場にお持ちください。

康楽株式会社

本社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-2-2セイキ第1ビル6F

東大柏ベンチャープラザ研究所: 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-19 304号

代表: TEL; 03-5834-3283、FAX; 03-6800-3139 HP: <https://www.krk-tokyo.co.jp>

